

ТЕХНОЛОГИИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ



ДИПОЛЬ

Официальный
дистрибьютор

MYDATA®
automation
WORLDWIDE

Высокоточные автоматы для установки
компонентов поверхностного монтажа



Для
быстро
меняющегося
мира



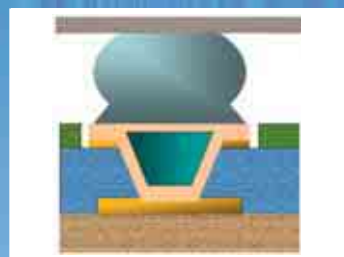
Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 23А
тел./факс
(812) 325-1478, 702-1266

Москва
Кутузовский проспект, 36
тел. (495) 775-0171
факс (495) 775-01-78

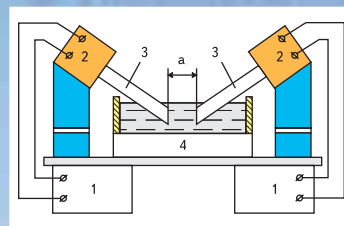
smt@dipaul.ru
www.dipaul.ru



Иммерсионное олово
как финишное покрытие.
Надежность прежде всего!



Усложненные
структуры МПП
с глухими
и скрытыми отверстиями



Бесфлюсовая
ультразвуковая пайка
в электронике



Форум по бессвинцовым
технологиям пайки

SAMSUNG SM321



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ПРОРЫВ В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Передовые технические решения
Лучший в своем классе

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

max 26'600
IPC 21'000

ТОЧНОСТЬ:

01005 \pm 50 мкм
QFP \pm 30 мкм

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

0402 (01005) – 55 x 55 мм
120 слотов
6 головок



ЗАО Предприятие ОСТЕК
121467, Россия, Москва,
ул. Молдавская, д. 5, стр. 2
Тел.: (495) 788-44-44



www.ostec-smt.ru

НПФ ОСТЕК
04050, Украина, Киев,
ул. Н. Пимоненко, д. 13, корп. 7, офис 6
Тел.: (044) 537-40-28

Контроль качества
Сжатые сроки
Низкие цены

ПРОМЫШЛЕННАЯ СБОРКА ЭЛЕКТРОНИКИ

Печатные платы и электронные компоненты под проект
Поверхностный монтаж 0402, BGA, CSP, mBGA
Выводной монтаж, Пайка Волной
Автоматизированный оптический контроль
Внутрисхемный электрический контроль
Программирование, Финишная сборка изделий

